

股票代碼：6202

盛群半導體股份有限公司及子公司
合併財務報告暨會計師核閱報告
民國一十二年及一十一年第一季

公司地址：新竹科學園區研新二路3號
電話：(03)563-1999

目 錄

項 目	頁 次
一、封 面	1
二、目 錄	2
三、會計師核閱報告書	3
四、合併資產負債表	4
五、合併綜合損益表	5
六、合併權益變動表	6
七、合併現金流量表	7
八、合併財務報告附註	
(一)公司沿革	8
(二)通過財務報告之日期及程序	8
(三)新發布及修訂準則及解釋之適用	8
(四)重大會計政策之彙總說明	9~11
(五)重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	11
(六)重要會計項目之說明	11~26
(七)關係人交易	27~28
(八)質押之資產	28
(九)重大或有負債及未認列之合約承諾	29
(十)重大之災害損失	29
(十一)重大之期後事項	29
(十二)其 他	29
(十三)附註揭露事項	
1.重大交易事項相關資訊	29~30
2.轉投資事業相關資訊	31~34
3.大陸投資資訊	34~37
4.主要股東資訊	37
(十四)部門資訊	37



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

新竹市科學園區300091展業一路11號
No. 11, Prosperity Road I, Hsinchu Science Park,
Hsinchu, 300091, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 3 579 9955
傳真 Fax + 886 3 563 2277
網址 Web kpmg.com/tw

會計師核閱報告

盛群半導體股份有限公司董事會 公鑒：

前言

盛群半導體股份有限公司及其子公司民國一一二年及一一一年三月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年及一一一年一月一日至三月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師核閱竣事。依證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製允當表達之合併財務報告係管理階層之責任，本會計師之責任係依據核閱結果對合併財務報告作成結論。

範圍

除保留結論之基礎段所述者外，本會計師係依照核閱準則2410號「財務報表之核閱」執行核閱工作。核閱合併財務報告時所執行之程序包括查詢(主要向負責財務與會計事務之人員查詢)、分析性程序及其他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於查核工作之範圍，因此本會計師可能無法察覺所有可藉由查核工作辨認之重大事項，故無法表示查核意見。

保留結論之基礎

如合併財務報告附註四(二)所述，列入上開合併財務報告之部份非重要子公司，係依該等被投資公司同期間未經會計師核閱之財務報告為依據，民國一一二年及一一一年三月三十一日之資產總額分別為1,761,213千元及1,954,133千元，分別占合併資產總額之27%及22%；負債總額分別為115,171千元及140,661千元，分別占合併負債總額之7%及5%；民國一一二年及一一一年一月一日至三月三十一日之綜合損益分別為(16,159)千元及137,569千元，其絕對值分別占合併綜合損益之10%及30%。

保留結論

依本會計師核閱結果，除保留結論之基礎段所述該等被投資公司財務報告倘經會計師核閱，對合併財務報告可能有所調整之影響外，並未發現上開合併財務報告在所有重大方面有未依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製，致無法允當表達盛群半導體股份有限公司及其子公司民國一十二年及一一一年三月三十一日之合併財務狀況，與民國一十二年及一一一年一月一日至三月三十一日之合併財務績效，及合併現金流量之情事。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

呂倩慧



鄭安志



證券主管機關：金管證審字第1040007866號
核准簽證文號：金管證審字第1060005191號
民國一十二年四月二十七日

民國一十二年及一十一年三月三十一日經核閱，未依審計準則查核
盛群半導體股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一十二年三月三十一日 一十一年三月三十一日及三月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	112.3.31		111.12.31		111.3.31			負債及權益	112.3.31		111.12.31		111.3.31	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%	金 額	%
流動資產：								流動負債：						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,284,172	19	933,978	14	1,367,287	15	2150 應付票據	\$ 51,879	1	104,072	2	220,928	2	
1110 透過損益按公允價值衡量之金融 資產—流動(附註六(二))	333,364	5	242,418	3	1,009,033	11	2170 應付帳款	399,499	6	560,097	8	632,662	7	
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(四))	76,029	1	94,178	1	157,409	2	2180 應付帳款—關係人(附註七)	51	-	178	-	117	-	
1180 應收帳款—關係人淨額(附註六(四) 及七)	588,301	9	819,670	12	901,260	10	2201 應付薪資及獎金	397,864	6	529,177	8	588,933	7	
130X 存貨(附註六(五))	2,031,294	31	1,822,934	27	997,406	11	2216 應付股利	-	-	-	-	2,690	-	
1476 其他金融資產—流動(附註六(六)、 七及八)	373,908	6	1,226,291	18	2,538,609	28	2230 本期所得稅負債	50,470	1	47,843	1	555,014	6	
1479 其他流動資產—其他	82,853	1	68,881	1	123,721	2	2280 租賃負債—流動(附註六(十一))	17,606	-	16,484	-	23,108	-	
	<u>4,769,921</u>	<u>72</u>	<u>5,208,350</u>	<u>76</u>	<u>7,094,725</u>	<u>79</u>	2310 預收款項	29,127	-	25,098	-	90,351	1	
非流動資產：							2399 其他流動負債—其他	<u>194,168</u>	<u>3</u>	<u>226,869</u>	<u>3</u>	<u>140,546</u>	<u>2</u>	
1518 透過其他綜合損益按公允價值衡 量之權益工具投資(附註六(三))	620,504	10	503,111	8	651,327	7		<u>1,140,664</u>	<u>17</u>	<u>1,509,818</u>	<u>22</u>	<u>2,254,349</u>	<u>25</u>	
1550 採用權益法之投資(附註六(七)及 七)	432,147	7	422,000	6	571,634	7	非流動負債：							
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八))	395,737	6	326,243	5	342,265	4	2570 遞延所得稅負債	422,707	7	422,707	6	407,387	5	
1755 使用權資產(附註六(九))	92,027	1	85,802	1	102,458	1	2580 租賃負債—非流動(附註六(十一))	76,755	1	71,637	1	81,537	1	
1780 無形資產(附註六(十))	23,939	-	23,498	-	28,780	-	2640 淨確定福利負債—非流動	33,084	1	48,497	1	75,848	1	
1840 遞延所得稅資產	144,335	2	146,803	2	191,076	2	2645 存入保證金	<u>22,930</u>	-	<u>22,696</u>	-	<u>26,080</u>	-	
1900 其他非流動資產	<u>118,302</u>	<u>2</u>	<u>104,189</u>	<u>2</u>	<u>26,217</u>	-		<u>555,476</u>	<u>9</u>	<u>565,537</u>	<u>8</u>	<u>590,852</u>	<u>7</u>	
	<u>1,826,991</u>	<u>28</u>	<u>1,611,646</u>	<u>24</u>	<u>1,913,757</u>	<u>21</u>	負債總計	<u>1,696,140</u>	<u>26</u>	<u>2,075,355</u>	<u>30</u>	<u>2,845,201</u>	<u>32</u>	
資產總計	<u>\$ 6,596,912</u>	<u>100</u>	<u>6,819,996</u>	<u>100</u>	<u>9,008,482</u>	<u>100</u>	權益(附註六(十四))：							
							歸屬母公司業主之權益：							
							3110 普通股股本	2,261,682	34	2,261,682	33	2,261,682	25	
							3200 資本公積	142,309	2	142,309	2	142,309	2	
							3300 保留盈餘	2,109,180	32	2,072,434	31	3,307,243	37	
							3400 其他權益	<u>320,335</u>	<u>5</u>	<u>202,572</u>	<u>3</u>	<u>393,897</u>	<u>4</u>	
							歸屬母公司業主之權益總計	<u>4,833,506</u>	<u>73</u>	<u>4,678,997</u>	<u>69</u>	<u>6,105,131</u>	<u>68</u>	
							36XX 非控制權益	<u>67,266</u>	<u>1</u>	<u>65,644</u>	<u>1</u>	<u>58,150</u>	-	
							權益總計	<u>4,900,772</u>	<u>74</u>	<u>4,744,641</u>	<u>70</u>	<u>6,163,281</u>	<u>68</u>	
							負債及權益總計	<u>\$ 6,596,912</u>	<u>100</u>	<u>6,819,996</u>	<u>100</u>	<u>9,008,482</u>	<u>100</u>	

董事長：吳啟勇



經理人：高國棟



(請詳閱後附合併財務報告附註)

~4~

會計主管：廖明通



僅經核閱，未依審計準則查核
盛群半導體股份有限公司及子公司
合併綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	112年1月至3月		111年1月至3月	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十七)及七)	\$ 760,834	100	1,918,345	100
5000 營業成本(附註六(五)、(十六)、七及十二)	394,440	52	870,154	45
營業毛利	366,394	48	1,048,191	55
5910 未實現銷貨利益之變動	(30,256)	(4)	60,757	3
已實現營業毛利	396,650	52	987,434	52
營業費用(附註六(十六)及十二)：				
6100 推銷費用	37,969	5	45,812	3
6200 管理費用	83,703	11	109,728	6
6300 研究發展費用	231,286	30	311,146	16
6450 預期信用減損損失(附註六(四))	-	-	8,000	-
	352,958	46	474,686	25
營業淨利	43,692	6	512,748	27
營業外收入及支出：				
7020 其他利益及損失(附註六(十八)及七)	18,194	2	56,582	3
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額(附註六(七))	(23,357)	(3)	34,830	2
7100 利息收入	7,355	1	5,064	-
7130 股利收入(附註六(三))	-	-	35,923	2
7510 利息費用(附註六(十一))	(309)	-	(375)	-
	1,883	-	132,024	7
稅前淨利	45,575	6	644,772	34
7950 所得稅費用(附註六(十三))	7,511	1	124,246	7
本期淨利	38,064	5	520,526	27
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	107,893	14	(135,619)	(7)
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	8,253	1	59,395	3
8371 採用權益法認列關聯企業之國外營運機構財務報表換算之兌換差額(附註六(七))	4,389	1	31,780	2
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十三))	2,468	-	17,902	1
後續可能重分類至損益之項目合計	10,174	2	73,273	4
8300 本期其他綜合損益	118,067	16	(62,346)	(3)
本期綜合損益總額	\$ 156,131	21	458,180	24
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 36,746	5	512,293	27
8620 非控制權益	1,318	-	8,233	-
	\$ 38,064	5	520,526	27
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 154,509	21	448,279	23
8720 非控制權益	1,622	-	9,901	1
	\$ 156,131	21	458,180	24
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十五))				
9750 基本每股盈餘	\$ 0.16		2.27	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 0.16		2.26	

董事長：吳啟勇



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：高國棟



會計主管：廖明通



僅經核閱 未依審計準則查核
 盛群半導體股份有限公司及子公司
 合併權益變動表
 民國一十二年及一十一年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	保留盈餘					國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益		歸屬於母公司業主之權益總計	非控制權益	權益總計	
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		合 計	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益				合 計
民國一十一年一月一日餘額	\$ 2,261,682	142,309	751,032	2,642	2,041,276	2,794,950	(58,206)	516,117	457,911	5,656,852	53,396	5,710,248
本期淨利	-	-	-	-	512,293	512,293	-	-	-	512,293	8,233	520,526
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	71,605	(135,619)	(64,014)	(64,014)	1,668	(62,346)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	512,293	512,293	71,605	(135,619)	(64,014)	448,279	9,901	458,180
子公司發放現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,147)	(5,147)
民國一十一年三月三十一日餘額	\$ 2,261,682	142,309	751,032	2,642	2,553,569	3,307,243	13,399	380,498	393,897	6,105,131	58,150	6,163,281
民國一十二年一月一日餘額	\$ 2,261,682	142,309	955,160	2,642	1,114,632	2,072,434	(29,710)	232,282	202,572	4,678,997	65,644	4,744,641
本期淨利	-	-	-	-	36,746	36,746	-	-	-	36,746	1,318	38,064
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	9,870	107,893	117,763	117,763	304	118,067
本期綜合損益總額	-	-	-	-	36,746	36,746	9,870	107,893	117,763	154,509	1,622	156,131
民國一十二年三月三十一日餘額	\$ 2,261,682	142,309	955,160	2,642	1,151,378	2,109,180	(19,840)	340,175	320,335	4,833,506	67,266	4,900,772

董事長：吳啟勇



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：高國棟



會計主管：廖明通



僅經核閱，未依審計準則查核
 盛群半導體股份有限公司及子公司
 合併現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	112年1月至3月	111年1月至3月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 45,575	644,772
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	19,779	20,621
攤銷費用	16,390	15,398
預期信用減損損失	-	8,000
利息費用	309	375
利息收入	(7,355)	(5,064)
股利收入	-	(35,923)
採用權益法認列之關聯企業損失(利益)之份額	23,357	(34,830)
聯屬公司間未實現銷貨利益之變動	(30,256)	60,757
其他不影響現金流量之損費淨額	2,293	(293)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產	(91,193)	(38,380)
應收票據及帳款(含關係人)	254,386	(129,962)
存貨	(206,241)	(105,432)
其他營業資產	(23,589)	(641)
應付票據及帳款(含關係人)	(215,272)	(81,450)
預收款項	3,070	(33,770)
淨確定福利負債	(15,535)	(5,777)
其他營業負債	(165,424)	(40,938)
營運產生之現金之流入(出)	(389,706)	237,463
收取之利息	10,856	5,416
收取之股利	-	18,149
支付之利息	(309)	(375)
支付之所得稅	(4,977)	(14,324)
營業活動之淨現金流入(出)	(384,136)	246,329
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(9,500)	(13,000)
採用權益法之被投資公司減資及清算退還股款	-	15,603
取得不動產、廠房及設備	(82,525)	(4,968)
取得無形資產	(16,825)	(4,831)
其他金融資產減少(增加)	849,597	(123,761)
其他非流動資產增加	(3,623)	(3,264)
收取之股利	-	35,923
投資活動之淨現金流入(出)	737,124	(98,298)
籌資活動之現金流量：		
存入保證金增加	200	-
租賃本金償還	(5,707)	(6,122)
非控制權益變動	-	(2,457)
籌資活動之淨現金流出	(5,507)	(8,579)
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,713	28,076
本期現金及約當現金增加數	350,194	167,528
期初現金及約當現金餘額	933,978	1,199,759
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,284,172	1,367,287

董事長：吳啟勇



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：高國棟



會計主管：廖明通



僅經核閱，未依審計準則查核
盛群半導體股份有限公司及子公司
合併財務報告附註

民國一十二年及一十一年第一季

(除另有註明者外，所有金額均以新台幣千元為單位)

一、公司沿革

盛群半導體股份有限公司(以下稱「本公司」)於民國八十七年十月一日依中華民國公司法及科學園區設置管理條例之規定成立，自民國八十七年十二月十一日開始營業，民國八十九年四月於香港設立分公司。本公司股票自民國九十一年十一月四日起於中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌買賣，自民國九十三年九月二十七日起改於台灣證券交易所股份有限公司掛牌買賣。

本公司及子公司(以下併稱「合併公司」)主要營業項目為各種積體電路之研究、開發、生產、製造及銷售。

二、通過財務報告之日期及程序

本合併財務報告已於民國一十二年四月二十七日經董事會通過發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一)已採用金融監督管理委員會(以下稱「金管會」)認可之新發布及修訂後準則及解釋之影響

合併公司自民國一十二年一月一日起開始適用下列新修正之國際財務報導準則，且對合併財務報告未造成重大影響。

- 國際會計準則第一號之修正「會計政策之揭露」
- 國際會計準則第八號之修正「會計估計值之定義」
- 國際會計準則第十二號之修正「與單一交易所產生之資產及負債有關之遞延所得稅」

(二)金管會尚未認可之新發布及修訂準則及解釋

合併公司預期下列尚未認可之新發布及修正準則不致對合併財務報告造成重大影響。

- 國際財務報導準則第十號及國際會計準則第二十八號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」
- 國際財務報導準則第十七號「保險合約」及國際財務報導準則第十七號之修正
- 國際會計準則第一號之修正「將負債分類為流動或非流動」
- 國際會計準則第一號之修正「具合約條款之非流動負債」
- 國際財務報導準則第十七號之修正「初次適用IFRS 17及IFRS 9比較資訊」
- 國際財務報導準則第十六號之修正「售後租回交易之規定」

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

四、重大會計政策之彙總說明

本合併財務報告所採用之重大會計政策彙總說明如下，下列會計政策已一致適用於本合併財務報告之所有表達期間。

(一) 遵循聲明

本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下稱「編製準則」)及金管會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製。本合併財務報告未包括依照金管會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下稱「金管會認可之國際財務報導準則」)所編製之整份年度合併財務報告應揭露之全部必要資訊。

除下列所述外，本合併財務報告所採用之重大會計政策與民國一一一年度合併財務報告相同，相關資訊請參閱民國一一一年度合併財務報告附註四。

(二) 合併基礎

合併財務報告編製原則與民國一一一年度合併財務報告一致，相關資訊請參閱民國一一一年度合併財務報告附註四(三)。

1. 列入合併財務報告之子公司

列入本合併財務報告之子公司包含：

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比		
			112.3.31	111.12.31	111.3.31
本公司	MCU Holdings Ltd. (MCU)	投資控股公司	100 %	100 %	100 %
本公司	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. (Holtek BVI)	投資控股公司	100 %	100 %	100 %
本公司	Sigmos Holdings Ltd. (Sigmos)	投資控股公司	100 %	100 %	100 %
本公司	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. (Kingtek BVI)	投資控股公司	100 %	100 %	100 %
本公司	盛凌投資股份有限公司(盛凌投資)	專業投資公司	100 %	100 %	100 %
MCU	Best Health Electronics Corp. (Best Health)	投資控股公司	75 % (註1)	75 % (註1)	80 % (註1)
Best Health	悠健電子(東莞)有限公司(悠健)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %	100 %
Best Health	Best Health Electronics HK Limited (Best Health HK)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %	100 %
MCU	Anchip Technology Corporation (Anchip)	投資控股公司	60 %	60 %	60 %
Anchip	安禧普電子科技(東莞)有限公司(安禧普)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %	100 %
MCU	Best Power Electronics Corp. (Best Power)	投資控股公司	- % (註2)	- % (註2)	100 % (註2)

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比		
			112.3.31	111.12.31	111.3.31
MCU	Best Driver-tech Corporation (Best Driver-tech)	投資控股公司	80 %	80 %	80 %
Best Driver-tech	芯動微電子(杭州)有限公司(芯動微)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %	100 %
MCU	Best Module-tech Corporation(Best Module-tech)	投資控股公司	100 %	100 %	100 %
Best Module-tech	易智芯科技(廈門)有限公司(易智芯)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %	100 %
Holtek BVI	芯群集成電路(廈門)有限公司(芯群)	製造及銷售與技術服務	100 % (註3)	100 % (註3)	100 % (註3)
Holtek BVI	合泰半導體(中國)有限公司(合泰)	製造及銷售與技術服務	100 % (註3)	100 % (註3)	100 % (註3)
Sigmos	Holtek Semiconductor (USA) Inc. (Holtek (USA))	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %	100 %
Kingtek BVI	金科集成電路(蘇州)有限公司(金科)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %	100 %
本公司及盛凌投資	Holtek Semiconductor (INDIA) Private Ltd. (Holtek INDIA)	製造及銷售與技術服務	100 % (註4)	100 % (註4)	100 % (註4)
盛凌投資	優方科技股份有限公司(優方)	製造及銷售與技術服務	54.75 % (註5)	54.75 % (註5)	54.75 % (註5)
優方	Best Solution Electronics Inc. (Best Solution)	投資控股公司	100 %	100 %	100 %
Best Solution	優方科技(東莞)有限公司(優方東莞)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %	100 %
盛凌投資	倍創科技股份有限公司(倍創)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %	100 %
倍創	Best Modules Corp.(Best Modules)	投資控股公司	100 %	100 %	100 %
Best Modules	倍易創新電子商務(廈門)有限公司(倍易創新)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %	100 %
盛凌投資	芯通科技股份有限公司(芯通)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %	100 %
芯通	BestComm RF Electronics Inc. (BestComm)	投資控股公司	100 %	100 %	100 %
BestComm	芯通電子科技(東莞)有限公司	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %	100 %

註1：合併公司於民國一一一年五月出售5%股權，至持股比例下降至75%。

註2：Best Power民國一一一年第四季進行清算並退回股款。

註3：其財務報告業經台灣母公司會計師核閱，其餘非重要子公司未經核閱。

註4：係盛凌投資持有99.9%股權及盛群持有0.1%股權。

註5：係盛凌投資直接持有40%股權及透過關聯企業持有36.875%股權所計算之綜合持股比例。

2.未列入合併財務報告之子公司：無。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(三)所得稅

合併公司係依國際會計準則公報第三十四號「期中財務報導」第B12段規定衡量及揭露期中期間之所得稅費用。

所得稅費用係以期中報導期間之稅前淨利乘以管理階層對於全年度預計有效稅率之最佳估計衡量，並全數認列為當期所得稅費用。

所得稅費用直接認列於權益項目或其他綜合損益項目者，係就相關資產及負債於財務報導目的之帳面金額與其課稅基礎之暫時性差異，以預期實現或清償時之適用稅率予以衡量。

(四)員工福利

期中期間之確定福利計畫退休金係採用前一年度報導日依精算決定退休金成本率，以年初至當期期末為基礎計算，並針對該報導日後之重大市場波動，及重大縮減、清償或其他重大一次性事項加以調整。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

管理階層依編製準則及金管會認可之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製本合併財務報告時，必須作出判斷、估計及假設，其將對會計政策之採用及資產、負債、收益及費用之報導金額有所影響。實際結果可能與估計存有差異。

編製合併財務報告時，管理階層於採用合併公司會計政策時所作之重大判斷以及估計不確定性之主要來源與民國一一一年度合併財務報告附註五一致。

會計政策涉及重大判斷，且對本合併財務報告已認列金額有重大影響之資訊如下：

對關聯企業是否具實質控制之判斷

合併公司持有關聯企業20%~41%之有表決權股份，其餘持股集中於特定股東，且合併公司無法取得該等關聯企業過半之董事席次，亦未取得股東會出席股東過半之表決權，故判定合併公司對該等關聯企業不具實質控制。

六、重要會計項目之說明

除下列所述外，本合併財務報告重要會計科目之說明與民國一一一年度合併財務報告尚無重大差異，相關資訊請參閱民國一一一年度合併財務報告附註六。

(一)現金及約當現金

	<u>112.3.31</u>	<u>111.12.31</u>	<u>111.3.31</u>
現金及活期存款	\$ 583,350	784,175	913,971
定期存款	<u>700,822</u>	<u>149,803</u>	<u>453,316</u>
	<u>\$ 1,284,172</u>	<u>933,978</u>	<u>1,367,287</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(二)透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動

	<u>112.3.31</u>	<u>111.12.31</u>	<u>111.3.31</u>
受益憑證	\$ <u>333,364</u>	<u>242,418</u>	<u>1,009,033</u>

1.敏感度分析、公允價值及市場風險資訊請詳附註六(十九)。

2.上述金融資產均未有提供作質押擔保之情形。

(三)透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資-非流動

	<u>112.3.31</u>	<u>111.12.31</u>	<u>111.3.31</u>
未上市(櫃)公司股票			
諧永投資股份有限公司(諧永投資)	\$ 561,189	453,828	559,509
Unitech Capital Inc. (Unitech)	53,358	45,697	81,489
精匠微電子股份有限公司(精匠微電子)	5,341	3,485	7,865
金佶科技股份有限公司(金佶科技)	<u>616</u>	<u>101</u>	<u>2,464</u>
	<u>\$ 620,504</u>	<u>503,111</u>	<u>651,327</u>

合併公司持有該等權益工具投資為長期策略性投資且非為交易目的所持有，故已指定為透過其他綜合損益按公允價值衡量。

1.敏感度分析、公允價值及市場風險資訊請詳附註六(十九)。

2.上述金融資產均未有提供作質押擔保之情形。

3.合併公司因上列指定為透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資，於民國一二年及一一年一月一日至三月三十一日認列之股利收入分別為0千元及35,923千元。

(四)應收票據及帳款淨額(含關係人)

	<u>112.3.31</u>	<u>111.12.31</u>	<u>111.3.31</u>
應收票據	\$ 2,766	357	432
應收帳款	78,972	98,483	164,370
應收關係人款	<u>703,739</u>	<u>935,755</u>	<u>909,260</u>
	785,477	1,034,595	1,074,062
減：備抵損失	<u>(121,147)</u>	<u>(120,747)</u>	<u>(15,393)</u>
	<u>\$ 664,330</u>	<u>913,848</u>	<u>1,058,669</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

合併公司針對所有應收款項採用簡化作法估計預期信用損失，亦即使用存續期間預期信用損失衡量，為此衡量目的，該等應收款項係按代表客戶依據合約條款支付所有到期金額能力之共同信用風險特性予以分組，並已納入前瞻性之資訊。合併公司應收款項之預期信用損失分析如下：

112.3.31			
	<u>應收款項 帳面金額</u>	<u>加權平均預期 信用損失率</u>	<u>備抵存續期間 預期信用損失</u>
未逾期	\$ 596,464	0.5%~3.5%	18,603
逾期90天以下	102,431	15.58%	15,962
逾期90天以上	<u>86,582</u>	100%	<u>86,582</u>
合計	<u>\$ 785,477</u>		<u>121,147</u>

111.12.31			
	<u>應收款項 帳面金額</u>	<u>加權平均預期 信用損失率</u>	<u>備抵存續期間 預期信用損失</u>
未逾期	\$ 757,376	0.5%~2.5%	17,567
逾期90天以下	192,478	9.58%	18,439
逾期90天以上	<u>84,741</u>	100%	<u>84,741</u>
合計	<u>\$ 1,034,595</u>		<u>120,747</u>

111.3.31			
	<u>應收款項 帳面金額</u>	<u>加權平均預期 信用損失率</u>	<u>備抵存續期間 預期信用損失</u>
未逾期	\$ 995,319	0.3%~1.5%	4,035
逾期90天以下	<u>67,157</u>	5%	<u>3,358</u>
合計	<u>\$ 1,062,476</u>		<u>7,393</u>

民國一一年三月三十一日因個別客戶應收帳款11,586千元，經評估有違約風險，故針對該客戶提列8,000千元預期信用損失。

合併公司應收票據及帳款之備抵損失變動表如下：

	112年 1月至3月	111年 1月至3月
期初餘額	\$ 120,747	7,393
認列之減損損失	-	8,000
匯率變動之影響數	<u>400</u>	-
期末餘額	<u>\$ 121,147</u>	<u>15,393</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(五)存貨

	<u>112.3.31</u>	<u>111.12.31</u>	<u>111.3.31</u>
原料及物料	\$ 992,763	616,123	140,544
在製品	510,487	522,963	275,407
製成品及商品	<u>528,044</u>	<u>683,848</u>	<u>581,455</u>
	<u>\$ 2,031,294</u>	<u>1,822,934</u>	<u>997,406</u>

營業成本組成明細如下：

	<u>112年 1月至3月</u>	<u>111年 1月至3月</u>
銷貨成本	\$ 392,582	869,985
報廢成本	<u>1,858</u>	<u>169</u>
	<u>\$ 394,440</u>	<u>870,154</u>

上述合併公司之存貨均未有提供作質押擔保之情形。

(六)其他金融資產－流動

	<u>112.3.31</u>	<u>111.12.31</u>	<u>111.3.31</u>
定期存款(三個月以上)	\$ 353,429	1,202,926	2,511,379
受限制銀行存款	8,918	8,918	8,913
其他	<u>11,561</u>	<u>14,447</u>	<u>18,317</u>
	<u>\$ 373,908</u>	<u>1,226,291</u>	<u>2,538,609</u>

合併公司於民國一一二年及一一一年一月一日至三月三十一日，針對其他金融資產並無提列減損損失情形。

其餘信用風險資訊請詳附註六(十九)。

(七)採用權益法之投資

合併公司於報導日採用權益法之投資列示如下：

	<u>112.3.31</u>	<u>111.12.31</u>	<u>111.3.31</u>
關聯企業其權益之彙總金額	\$ 734,181	754,290	922,855
減：聯屬公司間未實現交易利得	<u>(302,034)</u>	<u>(332,290)</u>	<u>(351,221)</u>
	<u>\$ 432,147</u>	<u>422,000</u>	<u>571,634</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

合併公司採用權益法之關聯企業屬個別不重大者，其彙總財務資訊如下，該等財務資訊係於合併公司之合併財務報告中所包含之金額：

	112年 1月至3月	111年 1月至3月
本期綜合損益總額歸屬於合併公司之金額：		
本期淨利(損)	\$ (23,357)	34,830
其他綜合損益	4,389	31,780
綜合損益總額	\$ (18,968)	66,610

Risingtek Corporation於民國一一一年三月進行清算並退還股款15,603千元。

上述合併公司之採用權益法之投資均未有提供作質押擔保之情形。

(八)不動產、廠房及設備

	土 地	房 屋 及 建 築	機 器 設 備	其 他 設 備	總 計
成本：					
民國112年1月1日餘額	\$ 26,676	523,653	393,425	113,260	1,057,014
本期增添	-	78,778	2,795	952	82,525
本期減少	-	-	(342)	(135)	(477)
匯率變動之影響	-	1,302	744	299	2,345
民國112年3月31日餘額	\$ 26,676	603,733	396,622	114,376	1,141,407
民國111年1月1日餘額	\$ 26,676	519,226	365,198	110,827	1,021,927
本期增添	-	360	3,106	1,502	4,968
本期減少	-	-	(1,874)	(129)	(2,003)
匯率變動之影響	-	9,050	5,136	2,066	16,252
民國111年3月31日餘額	\$ 26,676	528,636	371,566	114,266	1,041,144

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	土 地	房 屋 及 建 築	機 器 設 備	其 他 設 備	總 計
累計折舊：					
民國112年1月1日餘額	\$ -	315,875	318,604	96,292	730,771
本期折舊	-	3,892	8,499	1,666	14,057
本期減少	-	-	(337)	(84)	(421)
匯率變動之影響	-	464	555	244	1,263
民國112年3月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>320,231</u>	<u>327,321</u>	<u>98,118</u>	<u>745,670</u>
民國111年1月1日餘額	\$ -	302,003	288,870	87,261	678,134
本期折舊	-	3,146	7,710	3,321	14,177
本期減少	-	-	(1,873)	(128)	(2,001)
匯率變動之影響	-	3,124	3,774	1,671	8,569
民國111年3月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>308,273</u>	<u>298,481</u>	<u>92,125</u>	<u>698,879</u>
帳面價值：					
民國112年1月1日	<u>\$ 26,676</u>	<u>207,778</u>	<u>74,821</u>	<u>16,968</u>	<u>326,243</u>
民國112年3月31日	<u>\$ 26,676</u>	<u>283,502</u>	<u>69,301</u>	<u>16,258</u>	<u>395,737</u>
民國111年1月1日	<u>\$ 26,676</u>	<u>217,223</u>	<u>76,328</u>	<u>23,566</u>	<u>343,793</u>
民國111年3月31日	<u>\$ 26,676</u>	<u>220,363</u>	<u>73,085</u>	<u>22,141</u>	<u>342,265</u>

上述合併公司不動產、廠房及設備均未有提供作質押擔保之情形。

(九)使用權資產

	土 地	房 屋 及 建 築	總 計
帳面價值：			
民國112年1月1日	<u>\$ 55,352</u>	<u>30,450</u>	<u>85,802</u>
民國112年3月31日	<u>\$ 54,584</u>	<u>37,443</u>	<u>92,027</u>
民國111年1月1日	<u>\$ 58,158</u>	<u>50,744</u>	<u>108,902</u>
民國111年3月31日	<u>\$ 57,393</u>	<u>45,065</u>	<u>102,458</u>

合併公司使用權資產於民國一一二年及一一一年一月一日至三月三十一日間均無重大增添或處分之情形，本期折舊金額請詳附註十二，其他相關資訊請參閱民國一一年度合併財務報告附註六(九)。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(十)無形資產

	<u>電腦軟體</u>	<u>專利權</u>	<u>總計</u>
帳面價值：			
民國112年1月1日	\$ <u>16,837</u>	<u>6,661</u>	<u>23,498</u>
民國112年3月31日	\$ <u>18,815</u>	<u>5,124</u>	<u>23,939</u>
民國111年1月1日	\$ <u>22,133</u>	<u>17,078</u>	<u>39,211</u>
民國111年3月31日	\$ <u>15,181</u>	<u>13,599</u>	<u>28,780</u>

合併公司無形資產於民國一一二年及一一一年一月一日至三月三十一日間均無重大增添或處分之情形，本期攤銷金額請詳附註十二，其他相關資訊請參閱民國一一一年度合併財務報告附註六(十)。

上述合併公司之無形資產均未有提供作質押擔保之情形。

(十一)租賃負債

合併公司租賃負債之帳面金額如下：

	<u>112.3.31</u>	<u>111.12.31</u>	<u>111.3.31</u>
流動	\$ <u>17,606</u>	<u>16,484</u>	<u>23,108</u>
非流動	\$ <u>76,755</u>	<u>71,637</u>	<u>81,537</u>

到期分析請詳附註六(十九)。

認列於損益之金額如下：

	<u>112年 1月至3月</u>	<u>111年 1月至3月</u>
租賃負債之利息費用	\$ <u>309</u>	<u>375</u>
短期租賃之費用	\$ <u>2,238</u>	<u>1,024</u>
低價值租賃資產之費用(不包含短期租賃之低價值租賃)	\$ <u>161</u>	<u>152</u>

認列於現金流量表之金額如下：

	<u>112年 1月至3月</u>	<u>111年 1月至3月</u>
租賃之現金流出總額	\$ <u>8,415</u>	<u>7,673</u>

合併公司承租土地、房屋及建築作為辦公處所，土地之租賃期間通常為二十年，辦公處所之租賃期間通常為二至二十年，部份租賃包含在租賃期間屆滿時得延長與原合約相同期間之選擇權。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

部分土地及辦公室之租賃合約包含租賃延長之選擇權，該等合約係由各地區分別管理，因此所約定之個別條款及條件於公司內部有所不同。該等選擇權僅合併公司具有可執行之權利，出租人並無此權利。在無法合理確定將行使可選擇之延長租賃期間之情況下，與選擇權所涵蓋期間之相關給付並不計入租賃負債。

另，科學園區管理局土地合約之租賃給付取決於當地公告地價，並加計各園區再投入之公共設施建設費經攤算後辦理調整。

(十二)員工福利

因前一財務年度報導日後未發生重大市場波動及重大縮減、清償或其他重大一次性事項，故合併公司採用民國一一年及一〇年十二月三十一日精算決定之退休金成本衡量及揭露期中期間確定福利計畫之退休金成本。

合併公司之退休金費用，請參閱附註十二之說明。

(十三)所得稅

所得稅費用係以期中報導期間之稅前淨利乘以管理階層對於全年度預計有效稅率之最佳估計衡量。

合併公司所得稅費用明細如下：

	112年 1月至3月	111年 1月至3月
當期所得稅費用		
當期產生	\$ <u>7,511</u>	<u>124,246</u>

合併公司認列於其他綜合損益項下之所得稅費用明細如下：

	112年 1月至3月	111年 1月至3月
後續可能重分類至損益之項目：		
國外營運機構財務報告換算之兌換差額	\$ 1,651	11,879
採用權益法認列關聯企業之國外營運機構 財務報表換算之兌換差額	\$ <u>817</u>	<u>6,023</u>
	\$ <u>2,468</u>	<u>17,902</u>

本公司營利事業所得稅結算申報已奉稅捐稽徵機關核定至民國一〇年度。

(十四)資本及其他權益

除下列所述外，合併公司於民國一二年及一一年一月一日至三月三十一日間資本及其他權益無重大變動，相關資訊請參閱民國一一年度合併財務報告附註六(十四)。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

保留盈餘

依本公司章程規定，公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具股東股利分派議案，提請股東會決議分派不低於稅後淨利之百分之五十。

上述股東股利部份，其中現金股利不低於當年度發放股東現金股利及股東股票股利合計數之百分之五十。

依金管會民國一〇一年四月六日金管證發字第1010012865號令規定，本公司於分派可分配盈餘時，就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額與上段所提列特別盈餘公積餘額之差額，自當期損益與前期末分配盈餘補提列特別盈餘公積；屬前期累積之其他股東權益減項金額，則自前期末分配盈餘補提列特別盈餘公積不得分派。嗣後其他股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

本公司民國一一一年度及一一〇年度盈餘分派案，分別於民國一一二年三月八日及一一一年五月二十四日經董事會擬議及股東常會決議，分派予業主之股利如下：

	111年度		110年度	
	每股股利	金額	每股股利	金額
	(元)		(元)	
分派予普通股業主之現金股利	\$ 4.0000	904,673	8.1229	1,837,141

上述民國一一一年度盈餘分配案尚待股東會決議，相關資訊可至公開資訊觀測站等管道查詢。

(十五)每股盈餘

歸屬於本公司每股盈餘之計算列示如下：

	112年 1月至3月	111年 1月至3月
基本每股盈餘：		
歸屬於本公司股東之本期淨利	\$ 36,746	512,293
計算每股盈餘之加權平均流通在外股數(千股)	226,168	226,168
基本每股盈餘(元)	\$ 0.16	2.27

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	112年 1月至3月	111年 1月至3月
稀釋每股盈餘：		
歸屬於本公司股東之本期淨利	\$ <u>36,746</u>	<u>512,293</u>
加權平均流通在外股數(千股)	226,168	226,168
具稀釋作用潛在普通股之影響(千股)：		
員工酬勞	<u>232</u>	<u>848</u>
計算稀釋每股盈餘之加權平均流通在外股數(千股)	<u>226,400</u>	<u>227,016</u>
稀釋每股盈餘(元)	\$ <u>0.16</u>	<u>2.26</u>

(十六)員工及董事酬勞

依本公司章程規定，公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之一·五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

本公司民國一一二年及一一一年一月一日至三月三十一日員工酬勞估列金額分別為5,252千元及75,956千元，董事酬勞估列金額分別為625千元及9,042千元，係以本公司各該段期間之稅前淨利扣除員工酬勞及董事酬勞前之金額乘上本公司章程所訂之員工酬勞及董事酬勞分派成數為估計基礎，並列報為該段期間之營業成本或營業費用。若次年度實際分派金額與估列數有差異時，則視為會計估計變動，將該變動之差異認列為次年度損益。如董事會決議採股票發放員工酬勞，股票酬勞之股數計算基礎係依據董事會決議日前一日之收盤價。

本公司民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞提列金額分別為160,430千元及19,099千元，與本公司董事會擬議內容並無差異，民國一一〇年度員工酬勞及董事酬勞提列金額分別為299,875千元及35,499千元，皆係以現金發放，與實際分派情形並無差異，相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。

(十七)客戶合約之收入

1.收入之細分

	112年 1月至3月	111年 1月至3月
主要地區市場		
中國	\$ 439,176	1,328,995
臺灣	98,522	248,928
其他國家	<u>223,136</u>	<u>340,422</u>
	\$ <u>760,834</u>	<u>1,918,345</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	112年 1月至3月	111年 1月至3月
主要產品		
積體電路銷售	\$ 758,315	1,908,200
設計及燒錄收入	<u>2,519</u>	<u>10,145</u>
	<u>\$ 760,834</u>	<u>1,918,345</u>

2.合約餘額

應收帳款及其減損之揭露請詳附註六(四)。

(十八)營業外收入及支出

合併公司綜合損益表所列之其他利益及損失明細如下：

	112年 1月至3月	111年 1月至3月
外幣兌換淨利益	\$ 5,869	32,947
其他	<u>12,325</u>	<u>23,635</u>
	<u>\$ 18,194</u>	<u>56,582</u>

(十九)金融工具

除下列所述外，合併公司金融工具之公允價值及因金融工具而暴露於信用風險、流動性風險及市場風險之情形無重大變動，相關資訊請參閱民國一一一年度合併財務報告附註六(十九)。

1.信用風險

(1)信用風險之暴險

金融資產之帳面金額代表最大信用暴險金額。

(2)信用風險集中狀況

合併公司主要銷售對象為國內外信譽良好之公司，除依授信作業程序給予客戶信用額度外，並持續了解客戶之信用狀況，民國一一二年三月三十一日及一一一年十二月三十一日與三月三十一日佔合併公司應收票據及帳款(含關係人)10%以上客戶之帳款金額分別為216,602千元、344,065千元及275,417千元，使合併公司有應收帳款信用風險集中之情形，惟已定期評估應收帳款之回收可能性並提列適當備抵損失，管理當局預期未來不致有重大損失。

(3)應收款項及債務證券之信用風險

應收票據及帳款之信用曝險資訊請詳附註六(四)。

其他按攤銷後成本衡量之金融資產包括三個月以上定期存款及受限制銀行存款等，相關明細及減損提列情形請詳附註六(六)。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

上開均為信用風險低之金融資產，因此按十二個月預期信用損失金額衡量該期間之備抵損失(合併公司如何判定信用風險低之說明請詳民國一一一年度合併財務報告附註四(七))。

2.流動性風險

金融負債之合約到期日分析如下：

	帳面金額	合 約 現金流量	1年以內	超過1年
112年3月31日				
非衍生金融負債				
應付票據及帳款(含關係人)	\$ 451,429	451,429	451,429	-
應付薪資及獎金	397,864	397,864	397,864	-
應付費用(帳列其他流動負債)	54,415	54,415	54,415	-
存入保證金	22,930	22,930	-	22,930
租賃負債(流動及非流動)	94,361	103,994	18,781	85,213
	\$ 1,020,999	1,030,632	922,489	108,143
111年12月31日				
非衍生金融負債				
應付票據及帳款(含關係人)	\$ 664,347	664,347	664,347	-
應付薪資及獎金	529,177	529,177	529,177	-
應付費用(帳列其他流動負債)	69,980	69,980	69,980	-
存入保證金	22,696	22,696	-	22,696
租賃負債(流動及非流動)	88,121	97,853	17,581	80,272
	\$ 1,374,321	1,384,053	1,281,085	102,968
111年3月31日				
非衍生金融負債				
應付票據及帳款(含關係人)	\$ 853,707	853,707	853,707	-
應付薪資及獎金	588,933	588,933	588,933	-
應付費用(帳列其他流動負債)	99,776	99,776	99,776	-
應付股利	2,690	2,690	2,690	-
存入保證金	26,080	26,080	-	26,080
租賃負債(流動及非流動)	104,645	115,331	24,398	90,933
	\$ 1,675,831	1,686,517	1,569,504	117,013

合併公司並不預期到期日分析之現金流量發生時點會顯著提早，或實際金額會有顯著不同。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

3.市場風險—匯率風險

(1)匯率風險之暴險

合併公司暴露於重大外幣匯率風險之金融資產及負債如下：

	112.3.31			111.12.31			111.3.31		
	外幣	匯率	台幣	外幣	匯率	台幣	外幣	匯率	台幣
<u>金融資產</u>									
<u>貨幣性項目</u>									
美金	\$ 12,331	30.40	374,864	13,719	30.66	420,627	13,845	28.575	395,627
人民幣	98,918	4.4068	435,910	114,009	4.3843	499,849	110,965	4.4825	497,400
<u>非貨幣性項目</u>									
美金	\$ 19,028	30.40	578,463	19,382	30.66	594,239	24,251	28.575	692,973
<u>金融負債</u>									
<u>貨幣性項目</u>									
美金	\$ 10,981	30.40	333,814	15,126	30.66	463,752	12,935	28.575	369,619
人民幣	2,920	4.4068	12,869	3,481	4.3843	15,260	4,886	4.4825	21,901

(2)敏感性分析

合併公司之匯率風險主要來自於以外幣計價之現金、應收帳款及應付帳款等，於換算時產生外幣兌換損益。於民國一一二年及一一一年三月三十一日當新台幣相對於美金及人民幣貶值或升值1%，而其他所有因素維持不變之情況下，民國一一二年及一一一年一月一日至三月三十一日之稅後淨利將分別增加或減少3,713千元及4,012千元。

(3)貨幣性項目之兌換損益

由於合併公司使用貨幣種類繁多，故採彙整方式揭露貨幣性項目之兌換損益資訊，民國一一二年及一一一年一月一日至三月三十一日外幣兌換淨利益(含已實現及未實現)分別為5,869千元及32,947千元。

(4)其他價格風險

如報導日金融資產—價格變動(兩期分析係採用相同基礎，且假設其他變動因素不變)稅後損益之影響如下：

<u>報導日公允價值</u>	<u>112年1月至3月</u>		<u>111年1月至3月</u>	
	<u>其他綜合損益稅後金額</u>	<u>稅後損益</u>	<u>其他綜合損益稅後金額</u>	<u>稅後損益</u>
上漲1%	\$ <u>4,964</u>	<u>2,667</u>	<u>5,211</u>	<u>8,072</u>
下跌1%	\$ <u>(4,964)</u>	<u>(2,667)</u>	<u>(5,211)</u>	<u>(8,072)</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

4.公允價值資訊

(1)金融工具之種類及公允價值

合併公司之非衍生性短期金融工具以其在合併資產負債表上之帳面價值估計其公允價值，因為此類金融工具到期日甚近，故其帳面價值應屬估計公允價值之合理基礎。此方法應用於按攤銷後成本衡量之金融資產及金融負債，包含現金及約當現金、應收票據及帳款(含關係人)、應付票據及帳款(含關係人)、其他金融資產-流動、存出保證金及存入保證金等。

除上述金融工具及租賃負債依規定無須揭露公允價值資訊外，各財務報導日合併公司其餘各項金融工具之帳面價值及公允價值彙總如下：

	112.3.31				
	帳面價值	公允價值			合計
		第一級	第二級	第三級	
透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	\$ 333,364	333,364	-	-	333,364
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	620,504	-	-	620,504	620,504
	<u>\$ 953,868</u>	<u>333,364</u>	<u>-</u>	<u>620,504</u>	<u>953,868</u>
111.12.31					
	公允價值				
	帳面價值	第一級	第二級	第三級	合計
透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	\$ 242,418	242,418	-	-	242,418
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	503,111	-	-	503,111	503,111
	<u>\$ 745,529</u>	<u>242,418</u>	<u>-</u>	<u>503,111</u>	<u>745,529</u>
111.3.31					
	公允價值				
	帳面價值	第一級	第二級	第三級	合計
透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	\$ 1,009,033	1,009,033	-	-	1,009,033
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	651,327	-	-	651,327	651,327
	<u>\$ 1,660,360</u>	<u>1,009,033</u>	<u>-</u>	<u>651,327</u>	<u>1,660,360</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(2)按公允價值衡量金融工具之公允價值評價技術

A.合併公司持有之受益憑證係具有標準條款與條件並於活絡市場交易之金融資產，其公允價值係參照市場報價決定。

B.合併公司持有之金融工具屬無活絡市場者，其公允價值依類別及屬性列示如下：

- 無公開報價之權益工具：屬投資公司者，係使用淨資產價值法估算公允價值，資產法係經由評估評價標的涵蓋之個別資產及個別負債之總價值，以反映企業整體價值。
- 無公開報價之權益工具：其他投資標的，則係使用市場可比公司法估算公允價值，按同業之股價淨值比評估。

(3)民國一一二年及一一一年一月一日至三月三十一日間並無任何公允價值等級移轉情形。

(4)重大不可觀察輸入值(第三等級)之公允價值衡量之量化資訊

合併公司公允價值衡量歸類為第三等級為透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－權益證券投資。

合併公司歸類為第三等級之無活絡市場權益工具投資具有複數重大不可觀察輸入值。無活絡市場之權益工具投資之重大不可觀察輸入值因彼此獨立，故不存在相互關聯性。

重大不可觀察輸入值之量化資訊列表如下：

項目	評價技術	重大不可觀察輸入值	重大不可觀察輸入值與公允價值關係
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－無活絡市場之權益工具投資	市場法(可類比上市櫃公司同業股價淨值比)	<ul style="list-style-type: none"> • 股價淨值比乘數(112.3.31、111.12.31及111.3.31分別為0.97%~1.31%、1.20%~1.44%及1.86%~2.17%)) • 缺乏市場流通性折價(112.3.31、111.12.31及111.3.31皆為25%) 	<ul style="list-style-type: none"> • 股價淨值比乘數愈高，公允價值愈高 • 缺乏市場流通性折價愈高，公允價值愈低
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－無活絡市場之權益工具投資	淨資產價值法	<ul style="list-style-type: none"> • 淨資產價值 • 缺乏市場流通性折價(112.3.31、111.12.31及111.3.31均為10%) 	<ul style="list-style-type: none"> • 不適用 • 缺乏市場流通性折價愈高，公允價值愈低

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(5)第三等級間之變動明細

	透過其他綜合損益按公允價值衡量— 無公開報價之權益工具	
	112年1月至3月	111年1月至3月
1月1日餘額	\$ 503,111	773,946
新增	9,500	13,000
認列於其他綜合損益	107,893	(135,619)
3月31日餘額	<u>\$ 620,504</u>	<u>651,327</u>

上述總利益，係列報於「透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益」。

(二十)財務風險管理

合併公司財務風險管理目標及政策與民國一一一年度合併財務報告附註六(二十)所揭露者並無重大變動。

(廿一)資本管理

合併公司資本管理目標、政策及程序與民國一一一年度合併財務報告所揭露者一致；另作為資本管理之項目之彙總量化資料與民國一一一年度合併財務報告所揭露者亦無重大變動。相關資訊請參閱民國一一一年度合併財務報告附註六(廿一)。

(廿二)非現金交易之籌資活動

合併公司非現金交易籌資活動如下：

- 1.以租賃方式取得使用權資產，請詳附註六(九)。
- 2.來自籌資活動之負債之調節如下表：

	112.1.1	現金流量	其他(註)	112.3.31
租賃負債(流動及非流動)	\$ 88,121	(5,707)	11,947	94,361
存入保證金	22,696	200	34	22,930
來自籌資活動之負債總額	<u>\$ 110,817</u>	<u>(5,507)</u>	<u>11,981</u>	<u>117,291</u>

註：係合併公司因營運所需於民國一一二一年第一季承租辦公室所致。

	111.1.1	現金流量	其他	111.3.31
租賃負債(流動及非流動)	\$ 110,767	(6,122)	-	104,645
存入保證金	26,080	-	-	26,080
來自籌資活動之負債總額	<u>\$ 136,847</u>	<u>(6,122)</u>	<u>-</u>	<u>130,725</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

七、關係人交易

(一)關係人名稱及關係

於本合併財務報告之涵蓋期間內 與合併公司有交易之關係人如下：

關係人名稱	與合併公司之關係
Crown Rich Technology Holding Ltd.(Crown Rich)	合併公司之關聯企業
Fine Chip Electronics Inc.(Fine Chip)	合併公司之關聯企業
ForIC Electronics Holding Ltd.(ForIC)	合併公司之關聯企業
JXY Electronics Corporation(JXY)	合併公司之關聯企業
New Wave Electronics Holding Ltd.(New Wave)	合併公司之關聯企業
Newtek Electronics Ltd.(Newtek)	合併公司之關聯企業
Quanding Technology Holding Ltd.(Quanding)	合併公司之關聯企業
Santek Holdings Ltd.(Santek)	合併公司之關聯企業
Truetek Technology Ltd.(Truetek)	合併公司之關聯企業
Bestway Electronic Inc.(Bestway)	合併公司之關聯企業
欣宏電子股份有限公司(欣宏)	合併公司之關聯企業
金濤高科有限公司(金濤)	合併公司之關聯企業
宏達科技有限公司(宏達)	合併公司之關聯企業
鈺威科技股份有限公司(鈺威)	合併公司之關聯企業

(二)與關係人間之重大交易事項

1.銷售

合併公司對關係人之重大銷售金額如下：

	112年 1月至3月	111年 1月至3月
欣宏	\$ 213,512	324,198
關聯企業	232,872	933,988
	\$ 446,384	1,258,186

合併公司之銷售價格依銷售之產品規格而定，並視銷售之數量給予不定幅度之折扣；銷售予關係人之收款條件約為月結60天。合併公司與一般客戶之銷售交易收款條件則視個別客戶之交易往來經驗及債信評估結果決定採預收貨款、即期電匯或月結30天至60天不等。

民國一十二年三月三十一日及一十一年十二月三十一日與三月三十一日止，合併公司與採權益法評價之被投資公司間因銷貨交易所產生之未實現銷貨毛利分別為302,034千元、332,290千元及351,221千元，帳列採用權益法之投資項下。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

合併公司因上述銷貨交易產生之應收關係人款項(含備抵損失)明細如下：

	<u>112.3.31</u>	<u>111.12.31</u>	<u>111.3.31</u>
欣宏	\$ 216,602	241,551	275,417
TRUETEK	62,057	102,514	97,832
關聯企業	<u>309,642</u>	<u>475,605</u>	<u>528,011</u>
	<u>\$ 588,301</u>	<u>819,670</u>	<u>901,260</u>

2. 進貨

合併公司向關係人進貨金額如下：

	<u>112年 1月至3月</u>	<u>111年 1月至3月</u>
關聯企業	\$ <u>469</u>	<u>643</u>

合併公司與關係人間之進貨交易條件與一般供應商尚無明顯不同。

合併公司因上述交易產生之應付關係人款項明細如下：

	<u>112.3.31</u>	<u>111.12.31</u>	<u>111.3.31</u>
關聯企業	\$ <u>51</u>	<u>178</u>	<u>117</u>

3. 其他交易

民國一十二年及一十一年一月一日至三月三十一日合併公司向關聯企業收取人力支援等服務性質之收入分別為799千元及16,131千元。合併公司因前述交易及代墊等所產生之應收款項餘額，於民國一十二年三月三十一日及一十一年十二月三十一日與三月三十一日分別為2,128千元及2,349千元及16,630千元，帳列其他金融資產一流動項下。

(三) 主要管理人員交易

主要管理人員報酬如下：

	<u>112年 1月至3月</u>	<u>111年 1月至3月</u>
短期員工福利	\$ 9,384	14,610
退職後福利	<u>108</u>	<u>108</u>
	<u>\$ 9,492</u>	<u>14,718</u>

八、質押之資產

<u>資產名稱</u>	<u>質押擔保標的</u>	<u>112.3.31</u>	<u>111.12.31</u>	<u>111.3.31</u>
定期存款(帳列其他 金融資產一流動)	其他保證金	\$ <u>8,918</u>	<u>8,918</u>	<u>8,913</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

- (一)合併公司與ARM公司等簽有技術授權合約，合約中訂定當合併公司銷售之產品若有運用約定技術時，需依雙方議定價格支付權利金。
- (二)合併公司與一供應商簽訂產能保證合約，依約定支付保證金(帳列其他非流動資產項下)，約定合併公司需購買之相關年限及最低數量。合併公司考量市場需求，依合約估列相關合約負債準備，帳列其他流動負債項下。

十、重大之災害損失：無。

十一、重大之期後事項：無。

十二、其 他

員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總如下：

功 能 別 性 質 別	112年1月至3月			111年1月至3月		
	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計
員工福利費用						
薪資費用	7,322	190,660	197,982	10,323	307,411	317,734
勞健保費用	722	16,303	17,025	723	15,336	16,059
退休金費用	454	22,310	22,764	454	16,262	16,716
其他員工福利費用	329	4,522	4,851	475	6,156	6,631
折舊費用	474	19,305	19,779	1,815	18,806	20,621
攤銷費用	-	16,390	16,390	23	15,375	15,398

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊

民國一一二年一月一日至三月三十一日合併公司依編製準則之規定，應再揭露之重大交易事項相關資訊如下：

- 1.資金貸與他人：無。
- 2.為他人背書保證：無。
- 3.期末持有有價證券情形(不包含投資子公司、關聯企業及合資權益部分)：

數量單位：千股(單位)

持有之 公 司	有價證券 種類及名稱	與有價證券 發行人之關係	帳列科目	期 末				備註
				股 數	帳面金額	持股比率	公允價值	
本公司	第一金台灣貨幣市場基金	-	透過損益按公允價值 衡量之金融資產-流動	5,716	89,126	-	89,126	

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期 末				備註
				股 數	帳面金額	持股比率	公允價值	
本公司	統一強棒貨幣市場基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	14,372	244,238	-	244,238	
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	Unitech Capital Inc.	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具之投資-非流動	2,500	53,358	5.00 %	53,358	
盛凌投資股份有限公司	諧永投資股份有限公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具之投資-非流動	66,818	561,189	3.03 %	561,189	
盛凌投資股份有限公司	金佶科技股份有限公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具之投資-非流動	127	616	2.49 %	616	
盛凌投資股份有限公司	精匠微電子股份有限公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具之投資-非流動	1,125	5,341	19.91 %	5,341	

4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。
5. 取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。
6. 處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。
7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：無。
8. 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

單位：新台幣千元

帳列應收款項之公司	交易對象名稱	關係	應收關係人款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項期後收回金額	提列備抵損失金額
					金額	處理方式		
本公司	芯群	子公司	337,100	0.59	-	即期收款	57,866 (註)	10,711

註1：係截至民國一十二年四月二十日止收回之金額。

註2：相關交易及期末餘額已於合併財務報告中銷除。

9. 從事衍生性商品交易：無。
10. 母子公司間業務關係及重要交易往來情形：

編號	交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係	交易往來情形			
				科目	金額	交易條件	佔合併總營業收入或總資產之比率
0	本公司	合泰	母公司對子公司	銷貨收入	96,718	月結120天	13 %
0	本公司	芯群	母公司對子公司	銷貨收入	58,223	月結120天	8 %
0	本公司	芯群	母公司對子公司	應收帳款	326,389	月結120天	5 %
0	本公司	金科	母公司對子公司	銷貨收入	13,259	月結120天	2 %

註1：僅揭露銷貨及應收帳款佔合併總營收或總資產0.5%以上之交易，其相對之進貨及應付款項不再贅述。

註2：相關交易及期末餘額已於合併財務報告中銷除。

註3：應收帳款及票據餘額含備抵損失。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(二)轉投資事業相關資訊：

合併公司之轉投資事業資訊如下(不包含大陸被投資公司)：

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額			
本公司	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	665,449	665,449	22,053	100.00 %	1,309,603	(45,654)	(45,654)	本公司之子公司 註2
本公司	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	69,542	69,542	2,000	100.00 %	187,777	(6,647)	(6,647)	本公司之子公司 註2
本公司	Sigmos Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	6,898	6,898	200	100.00 %	22,642	(193)	(193)	本公司之子公司 註2
Sigmos Holdings Ltd.	Holtek Semiconductor (USA),INC.	美國加州	積體電路買賣及技術服務	6,898	6,898	2,000	100.00 %	22,642	(193)	(193)	註1,2 本公司之孫公司
本公司	MCU Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	16,333	16,333	500	100.00 %	1,219,615	(9,330)	(9,330)	本公司之子公司 註2
MCU Holdings Ltd.	ForIC Electronics Holding Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	9,733	9,733	300	40.00 %	36,307	(13,318)	(13,318)	註1 本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
ForIC Electronics Holding Ltd.	E-Micro Technology Holding Ltd.(BVI)	B.V.I.	電子元器件及單片機芯片的技術研發與諮詢服務	9,473	9,473	300	100.00 %	15,471	(1,052)	(1,052)	註1 本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
ForIC Electronics Holding Ltd.	ForIC Electronics HK Limited	香港	電子元器件及單片機芯片的技術支持與諮詢服務	866	866	200	100.00 %	34,870	315	315	註1 本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	Truetek Technology Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	16,306	16,306	920	40.00 %	65,995	(11,443)	(11,443)	註1 本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
Truetek Technology Ltd.	Truetek Technology HK Limited	香港	電子元器件及單片機芯片的技術研發與諮詢服務	34,652	34,652	8,000	100.00 %	91,906	(306)	(306)	註1 本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	Quanding Technology Holding Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	31,124	31,124	1,045	40.00 %	51,634	(2,280)	(2,280)	註1 本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
Quanding Technology Holding Ltd.	Quanding Technology HK Limited	香港	電子元器件及單片機芯片的技術研發與諮詢服務	2,137	2,137	500	100.00 %	25,036	110	110	註1 本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	Santek Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	3,758	3,758	180	40.00 %	65,916	(5,672)	(5,672)	註1 本公司之子公司採權益法評價之被投資公司

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額			
Santek Holdings Ltd.	Santek Electronics HK Limited	香港	投資並提供電子元件與單片機蕊片之應用與技術諮詢	8,662	8,662	2,000	100.00 %	89,268	(3,935)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	Bestway Electronic Inc.	B.V.I.	投資海外各項事業	3,470	3,470	800	40.00 %	6,601	(859)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Newwave Electronics Holding Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	24,784	24,784	800	40.00 %	89,354	(5,069)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Newtek Electronics Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	8,105	8,105	1,501	40.61 %	78,869	2,285	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
Newtek Electronics Ltd.	Newtek Electronics HK Limited	香港	投資並提供電子元件與單片機蕊片之應用與技術諮詢	8,662	8,662	2,000	100.00 %	23,375	514	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	Crown Rich Technology Holding Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	2,641	2,641	80	40.00 %	139,650	(5,820)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Fine Chip Electronics Inc.	B.V.I.	投資海外各項事業	7,039	7,039	1	40.00 %	-	(943)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Anchip Technology Corporation	B.V.I.	投資海外各項事業	2,937	2,937	1	60.00 %	34,120	1,090	註1、2	本公司之孫公司
MCU Holdings Ltd.	金濟高科有限公司	香港	電子零件之銷售及技術服務	9,907	9,907	2,400	40.00 %	25,959	(461)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	滋達科技有限公司	香港	電子零件設計及銷售	5,427	5,427	1,275	33.33 %	8,481	(1,503)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	JXY Electronics Corporation	B.V.I.	投資海外各項事業	6,405	6,405	1	40.00 %	9,697	(1,154)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Best Health Electronics Corporation	B.V.I.	投資海外各項事業	19,808	19,808	5	75.00 %	52,573	5,859	註1、2	本公司之孫公司
Best Health Electronics Corporation	Best Health Electronics HK Limited	香港	電子元器件與單片機芯片的技術支持與諮詢服務	1,299	1,299	300	100.00 %	17,330	(1,097)	註1、2	本公司之孫公司投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	Best Driver-Tech Corporation	B.V.I.	投資海外各項事業	6,753	6,753	2	80.00 %	19,684	872	註1、2	本公司之孫公司
MCU Holdings Ltd.	Best Module-Tech Corpoation	B.V.I.	投資海外各項事業	12,426	12,426	3	100.00 %	13,583	44	註1、2	本公司之孫公司

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註	
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
本公司	Holtek Semiconductor (India) Private Limited	INDIA	電子元器件及單片機晶片之技術支持與諮詢服務業務	3	3	6	0.10 %	2	359	- 註2	本公司之孫公司	
本公司	盛凌投資股份有限公司	新竹市	專營投資業務	429,826	429,826	42,983	100.00 %	890,179	(5,239)	(5,239)	註2	本公司之子公司
盛凌投資股份有限公司	欣宏電子股份有限公司	台北市	電子零組件製造/批發/零售	95,941	95,941	7,880	40.00 %	139,058	(10,940)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	
欣宏電子股份有限公司	A-ONE Wireless Technology Corp.	B.V.I.	投資海外各項事業	59,204	59,204	2,000	100.00 %	129,682	(9,636)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司	
欣宏電子股份有限公司	Innotek Electronics Inc.	B.V.I.	投資海外各項事業	79,680	79,680	2,000	100.00 %	165,495	4,925	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司	
欣宏電子股份有限公司	優方科技股份有限公司	台北市	電子零組件製造、電子材料批發零售、電腦及其週邊設備製造、資訊軟體服務及國際貿易	7,375	7,375	738	36.88 %	17,989	(1,672)	註1、2	本公司之孫公司	
盛凌投資股份有限公司	銻威科技股份有限公司	新北市	一般投資業	11,191	11,191	1,119	22.38 %	23,855	(3,157)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	
盛凌投資股份有限公司	優方科技股份有限公司	台北市	電子零組件製造、電子材料批發零售、電腦及其週邊設備製造、資訊軟體服務及國際貿易	8,000	8,000	800	40.00 %	19,514	(1,672)	註1、2	本公司之孫公司	
優方科技股份有限公司	Best Solution Electronics Inc.	B.V.I.	投資海外各項事業	6,140	6,140	200	100.00 %	41,004	(613)	註1、2	本公司之孫公司投資之子公司	
盛凌投資股份有限公司	天宇微機電股份有限公司	新竹市	電子零組件製造、電子材料批發零售、電信器材批發零售、智慧財產權業、資訊軟體服務及國際貿易	10,002	10,002	380	20.00 %	-	887	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	
盛凌投資股份有限公司	芯通科技股份有限公司	新竹市	電子零組件製造、電子材料批發零售、國際貿易業及資訊軟體服務	40,000	40,000	4,000	100.00 %	22,535	853	註1、2	本公司之孫公司	
芯通科技股份有限公司	Bestcomm RF Electronics Inc.	B.V.I.	投資海外各項事業	14,054	14,054	30	100.00 %	13,921	11	註1、2	本公司之孫公司投資之子公司	
盛凌投資股份有限公司	倍創科技股份有限公司	新竹市	電子零組件製造、電子材料批發、無店面零售業、國際貿易業	105,000	105,000	10,500	100.00 %	94,938	(734)	註1、2	本公司之孫公司	

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額			
倍創科技股份有限公司	Best Modules Corp.	B.V.I.	投資海外各項事業	28,326	28,326	7	100.00 %	30,338	524	註1、2	本公司之孫公司投資之子公司
盛凌投資股份有限公司	Holtek Semiconductor (India) Private Limited	INDIA	電子元器件及單片機晶片之技術支持與諮詢服務業務	2,945	2,945	6,479	99.90 %	2,673	359	註1、2	本公司之孫公司

註1：對各該公司投資損益之認列已分別包含於對子公司或孫公司之投資損益中。

註2：相關交易及期末餘額已於合併財務報告中銷除。

(三)大陸投資資訊：

1.轉投資大陸地區之事業相關資訊：

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	本期認列投資損益	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益
					匯出	收回						
芯群集成電路(廈門)有限公司	積體電路買賣及技術服務	322,726	(註1)	290,645	-	-	290,645	(37,020)	100 %	(37,020) (註5)	383,186	-
合泰半導體(中國)有限公司	集成電路及電子元器件及單片機晶片的批發與進出口業務並提供技術諮詢服務	292,423	(註1)	272,221	-	-	272,221	(8,880)	100 %	(8,880) (註5)	834,057	-
新緯科技(深圳)有限公司	電子零件銷售及售後服務	6,769	(註1)	3,383	-	-	3,383	(454)	40 %	(182)	7,713	-
新禾(廈門)電子有限公司	電子元器件及單片機晶片的技術支持與諮詢服務	6,398	(註1)	2,506	-	-	2,506	(1,509)	40 %	(604)	73,952	-
諾華達電子(深圳)有限公司	電子元器件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	9,287	(註1)	3,928	-	-	3,928	(5,108)	40 %	(2,043)	183,629	-
華榮匯電子科技(北京)有限公司	電子元器件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	19,361	(註1)	3,601	-	-	3,601	(12,255)	40 %	(4,902)	13,211	-
振揚電子(青島)有限公司	電子元器件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	6,315	(註1)	2,634	-	-	2,634	(1,052)	40 %	(421)	15,288	-
新鼎電子(深圳)有限公司	電子元器件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	65,860	(註1)	2,647	-	-	2,647	1,777	40.61 %	722	133,317	-
信霖微智電子(上海)有限公司	電子元器件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	30,293	(註1)	3,911	-	-	3,911	(11,048)	40 %	(4,419)	72,433	-

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	本期認列投資損益	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益
					匯出	收回						
華瑞昇電子(深圳)有限公司	電子元器件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	18,446	(註1)	1,964	-	-	1,964	(5,818)	40 %	(2,327)	338,176	-
全鼎電子(蘇州)有限公司	電子元器件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	21,670	(註1)	1,600	-	-	1,600	(2,298)	40 %	(919)	77,964	-
金科集成電路(蘇州)有限公司	電子零件銷售及售後服務	69,712	(註1)	69,712	-	-	69,712	(6,646)	100 %	(6,646)	187,737	-
健芳電子科技(上海)有限公司	電子元器件及單片機晶片的技術研發與諮詢服務	7,541	(註1)	-	-	-	-	(938)	40 %	(375)	(3,471)	-
安禧普電子科技(東莞)有限公司	電子元器件及單片機晶片的技術研發與諮詢服務	1,521	(註1)	-	-	-	-	1,089	60 %	654	55,704	-
集芯源電子科技(深圳)有限公司	電子元器件及單片機晶片的技術研發與諮詢服務	11,974	(註1)	-	-	-	-	(1,154)	40 %	(462)	23,731	-
悠健電子(東莞)有限公司	電子元器件及單片機晶片的技術研發與諮詢服務	23,057	(註1)	-	-	-	-	6,960	75 %	5,220	51,554	-
芯通電子科技(東莞)有限公司	集成電路、電子元器件、單片機晶片的技術研發、技術服務及銷售	13,634	(註1)	9,392	-	-	9,392	16	100 %	16	13,155	-
優方科技(東莞)有限公司	集成電路、電子元器件、單片機晶片的技術研發、技術服務及銷售	4,285	(註1)	-	-	-	-	(610)	54.75 %	(334)	38,898	-
芯動微電子(杭州)有限公司	集成電路、電子元器件、單片機晶片的技術研發、技術服務及銷售	6,361	(註1)	-	-	-	-	862	80.00 %	690	22,337	-
易智芯科技(廈門)有限公司	設計、開發、生產集成電路、電子元器件及單片機晶件及其所需的組件及軟件產品，並提供相關技術諮詢及售後服務	10,573	(註1)	-	-	-	-	33	100.00%	33	11,325	-

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	本期認列投資損益	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益
					匯出	收回						
倍易創新電子商務(廈門)有限公司	從事互聯網銷售、集成電路、電子元器件、單片機芯片及其所需的組件及軟件產品的技術開發、技術服務及銷售	28,307	(註1)	28,307	-	-	28,307	524	100.00%	524	30,306	-

2.轉投資大陸地區限額：

公司名稱	本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額(註2)	經濟部投審會核准投資金額(註3)	依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額(註4)
盛群	658,752 (美金21,851千元)	818,632 (美金26,929千元)	2,900,104
倍創	28,307 (美金962千元)	29,250 (美金962千元)	80,000
芯通	9,392 (美金314千元)	13,843 (美金455千元)	80,000
優方	-	4,341 (美金143千元)	80,000

註1：透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。

註2：累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額係依實際匯出之歷史匯率換算之新台幣金額。

註3：經濟部投審會核准投資金額係以報導日匯率換算新台幣金額；盛群經核准之金額係核准自台灣匯出投資金額計664,350千元(美金21,854千元)及第三地區之盈餘轉增資金額計154,282千元(美金5,075千元)；芯通經核准之金額係核准自台灣匯出投資金額計9,530千元(美金314千元)及第三地區之盈餘轉增資金額計4,313千元(美金141千元)；優方經核准之金額係核准第三地區之盈餘轉增資金額計4,341千元(美金143千元)；倍創經核准之金額係核准自台灣匯出投資金額計29,250千元(美金962千元)。

註4：依「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」規定，本公司對大陸投資累計金額未超過主管機關所定投資金額或比例上限。本公司之限額計算為淨值4,833,506千元 \times 60%=2,900,104千元；因芯通、優方及倍創符合在大陸地區從事投資或技術合作審查原則規定屬中小企業標準，限額為80,000千元或淨值其較高者。

註5：係依同期間經台灣母公司會計師核閱之財務報告認列投資損益。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

3.與大陸被投資公司間之重大交易事項：

合併公司民國一一二年度第一季與大陸被投資公司直接或間接之重大交易事項，請詳「重大交易事項相關資訊」之說明。

(四)主要股東資訊：

單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
聯華電子股份有限公司		22,144,257	9.79 %

十四、部門資訊

合併公司主要營運項目為積體電路之研究、開發、生產、製造及銷售，為單一營運部門。營運部門資訊與合併財務報告一致，收入(來自外部客戶收入)及部門損益請詳合併綜合損益表；部門資產請詳合併資產負債表。